

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年4月14日
【会社名】	ウシオ電機株式会社
【英訳名】	USHIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 朝日 崇文
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー31階
【電話番号】	03(5657)1000(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 伊藤 広己
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー31階
【電話番号】	03(5657)1000(大代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 伊藤 広己
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2026年4月14日付けの会社法第370条に基づく取締役会決議により、当社の半導体レーザーデバイス事業（以下、「対象事業」といいます。）を、当社が新たに設立予定の会社（以下「新設会社」といいます。）に対して吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の方法により承継させた上で、新設会社の全株式を京セラ株式会社へ譲渡する（以下「本株式譲渡」といい、本吸収分割と合わせて「本件取引」といいます。）ことを決定し、株式譲渡契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。）を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	未定
本店の所在地	未定
代表者の氏名	未定
資本金の額	未定
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	半導体レーザーデバイス製品の製造、販売

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

新設会社は、今後設立予定であるため、本臨時報告書提出日現在、終了した事業年度はありません。

(3) 大株主の名称及び発行済株式会社の総数に占める大株主の持株数の割合

ウシオ電機株式会社（提出会社） 100%

(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当該会社は未設立であるため、本報告書提出日現在、当社との間に資本関係はありません。 なお、設立後は当社が当該会社株式の100%を保有する予定であります。
人的関係	当該会社は未設立であるため、本報告書提出日現在、当社との間に人的関係はありません。 なお、設立後は当社の役職員が当該会社の取締役に就任する予定であり、具体的な就任者及び人数については未定であります。
取引関係	当該会社は未設立であるため、本報告書提出日現在、当社との間に取引関係はありません。

2. 当該吸収分割の目的

当社は、40年以上にわたる光技術の蓄積を基盤として、青紫から赤外にわたる幅広い波長帯で高出力・高信頼性の半導体レーザーデバイス事業を展開しており、特にGaAs（ガリウムヒ素）基板を用いた赤色レーザー分野において競争力のある製品・技術を有しています。

近年、生成AIの普及を背景としたデータセンター向け投資の拡大により半導体関連需要の構造が大きく変化する一方、汎用半導体向け市況の回復は長期にわたり低迷しております。加えて、医療及びセンシング分野では高出力レーザーへの需要が拡大するなど、事業環境は構造的な変化の局面にあります。

このような状況の下、メタバース分野におけるARグラス等向けにRGBレーザーダイオードの開発を進めている京セラから対象事業との協業に関する提案を受け、協議を重ねた結果、当社が2024年に策定した新成長戦略「Revive Vision 2030」に基づく資本効率の向上及び事業ポートフォリオの最適化を図るために、本件取引を実施することといたしました。

3. 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1) 吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、新設会社を吸収分割承継会社とする簡易吸収分割の方式を採用いたします。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、新設会社から当社への株式の割当て、金銭その他の財産の交付はありません。

(3) その他の吸収分割契約の内容

本吸収分割を含む本件取引の日程

本件取引に係る取締役会決議日	: 2026年4月14日
本株式譲渡契約締結日	: 2026年4月14日
新設会社の設立日	: 2026年12月(予定)
吸収分割契約承認に係る取締役会決議日	: 2026年12月(予定)
吸収分割契約締結日	: 2026年12月(予定)
本吸収分割効力発生日	: 2027年4月(予定)
本株式譲渡実行日	: 2027年4月(予定)

(注1) 本吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割であるため、吸収分割契約に関する当社の株主総会の承認決議を経ずに行います。

(注2) 本件の実行は契約に定める前提条件が満たされることを条件としております。

本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

本吸収分割により増減する資本金
本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

新設会社が承継する権利義務

新設会社は、本吸収分割により、本吸収分割の効力発生日において、本吸収分割に係る吸収分割契約に定める対象事業に係る資産、債務等の権利義務を承継いたします。

債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以降における、新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断しております。

4. 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	未定
本店の所在地	未定
代表者の氏名	未定
資本金の額	未定
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	半導体レーザーデバイス製品の製造、販売
決算期	3月31日

以上